

技術紹介

6 f-CONNECT 5475芯LGAソケットの開発

Development of Super Large Scale LGA Socket (f-CONNECT)

樋口 孝二 Koji Higuchi

コネクタ開発本部

キーワード： LGA ソケット、弾性体、金属膜、低背、低荷重

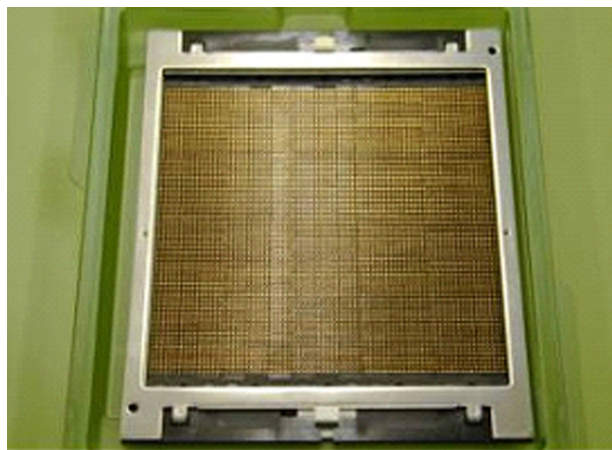
Keywords : LGA socket, gum, metal plating, low-profile, low-force

要 旨

航空電子は“f-CONNECT”の基本技術の特長を生かして、超多芯数の LGA ソケットを開発、製品化しました。“f-CONNECT”は従来コネクタの約 1/50 以下の接触圧力で安定接触が得られることから、従来では実現不可能な超多芯数の LGA ソケットを実現することができました。ここでは基本的な構造及び性能について紹介します。

SUMMARY

JAE developed and started sales of LGA socket with ultra multiple contacts based on our proven technology of the “f-CONNECT.” Since stable contact is provided in the “f-CONNECT” with contact pressure of under about 1/50 compared to the traditional connectors, we can realize this LGA socket with ultra multiple contacts that was impossible by the traditional technology. In this report, we introduce basic structure and performance of the LGA socket.



5475 芯 LGA ソケット